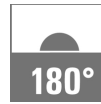


**USB-MIC2.0B S1V 1N1 RL BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	OMINMATE Data – USB-Buchse, USB Buchsen, 480 MBit/s, SMD-Lötanschluss, 180°, ≥ 10000, Raster in mm (P): 0.65 mm, Polzahl: 5, LCP, schwarz, Tape
Best.-Nr.	<a href="#">2762070000</a>
Art	USB-MIC2.0B S1V 1N1 RL BK
GTIN (EAN)	4064675035299
VPE	2.000 Stück
Verpackung	Tape

Erstellungs-Datum 7. Juni 2024 03:21:38 MESZ

Katalogstand 01.06.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

## USB-MIC2.0B S1V 1N1 RL BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

Tiefe	2,9 mm	Tiefe (inch)	0,114 inch
Höhe	10,51 mm	Höhe (inch)	0,414 inch
Breite	7,99 mm	Breite (inch)	0,315 inch
Nettogewicht	0,299 g		

## Elektrische Eigenschaften

Durchgangswiderstand	<25 mΩ	Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ
Nennspannung	48 V	Nennstrom	1 A
Spannungsfestigkeit Kontakt / Kontakt	100 V AC		

## Systemkennwerte

Abgangswinkel	180°	Anschlussart	Buchse
LED	Nein	Leistungs-Kategorie	480 MBit/s
Lötstift-Abmessungen	oktogonal	Lötstiftlänge (l)	0 mm
Lötstiftposition-Toleranz	± 0,1 mm	Lötverfahren	Reflow-Löten, Handlöten
Montage auf der Leiterplatte	SMD-Lötanschluss	Polzahl	5
Produktfamilie	OMINMATE Data – USB-Buchse	Raster in Zoll (P)	0,026 "
Raster in mm (P)	0,65 mm	Schirmmaterial	Edelstahl
Schirmoberfläche	vernickelt	Schirmung	Ja
Schutzart	IP20	Steckkraft/Pol, max.	35 N
Steckzyklen	≥ 10000	Ziehkraft/Pol, min.	10 N
Übertragungsrate	480 MBit/s		

## Werkstoffdaten

Isolierstoff	LCP	Farbe	schwarz
Farbtabelle (ähnlich)	RAL 9011	Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ
Moisture Level (MSL)	1	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Kontaktbasismaterial	Kupferlegierung	Kontaktmaterial	Cu-leg
Kontaktoberfläche	Gold über Nickel	Schichtaufbau - Steckkontakt	≤ 1 μ" Au
Lagertemperatur, min.	-40 °C	Lagertemperatur, max.	70 °C
Betriebstemperatur, min.	-30 °C	Betriebstemperatur, max.	80 °C

## Verpackungen

Verpackung	Tape	VPE Länge	462 mm
VPE Breite	450 mm	VPE Höhe	166 mm

## Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002637	ETIM 7.0	EC002637
ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ECLASS 9.0	27-44-04-02	ECLASS 9.1	27-44-04-02
ECLASS 10.0	27-44-04-02	ECLASS 11.0	27-46-02-01
ECLASS 12.0	27-46-02-01	ECLASS 13.0	27-46-02-01

## Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

## USB-MIC2.0B S1V 1N1 RL BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Downloads

Engineering-Daten	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Produktänderungsmitteilung	<a href="#">Änderung der Verpackung – 2762070000 USB-MIC2.0B S1V 1N1 RL BK</a> <a href="#">Change of packaging – 2762070000 USB-MIC2.0B S1V 1N1 RL BK</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## USB-MIC2.0B S1V 1N1 RL BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

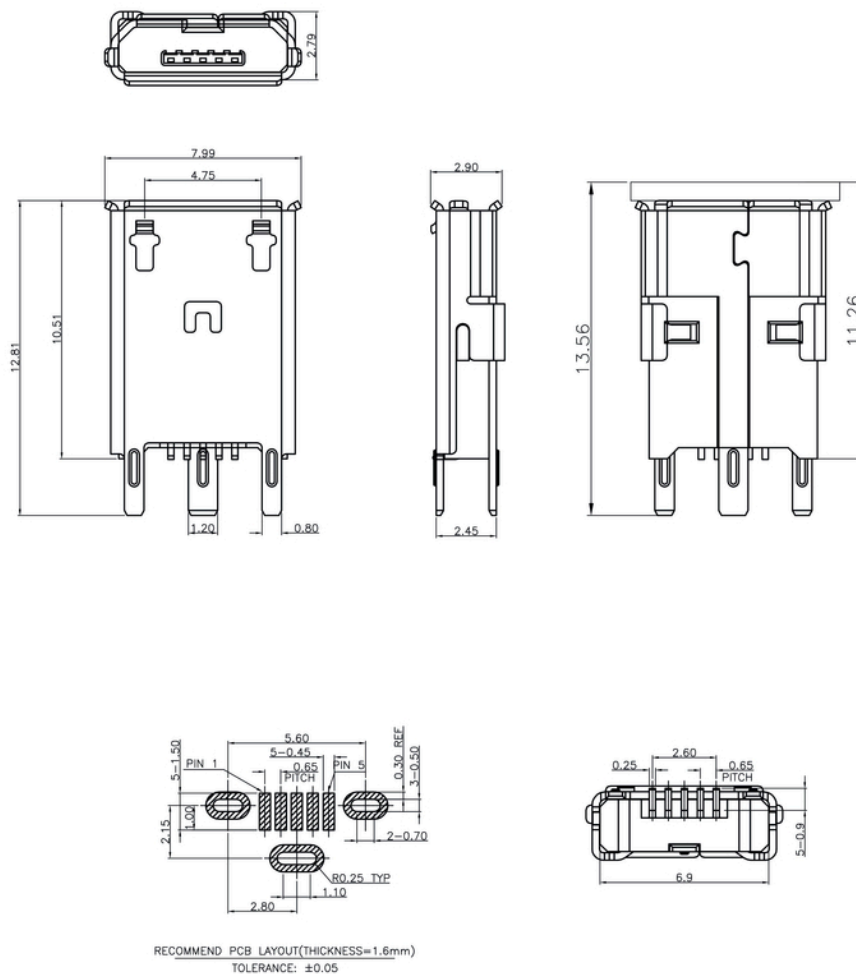
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen



www.weidmueller.com



**Empfohlenes Reflow-Lötprofil****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Reflow Lötprofil**

Das ideale Temperaturprofil für die Surface Mount Technology (SMT) ist eine häufig gestellte Frage in der Produktionswelt. Eine eindeutige Antwort gibt es nicht. Der Temperatur-Zeit-Verlauf ist abhängig von den Verarbeitungseigenschaften der Lotpaste und den Belastungsgrenzen der Bauelemente.

Folgende Parameter sind zu berücksichtigen:

- Vorheizzeit
- Maximale Temperatur
- Zeit oberhalb des Pasten-Schmelzpunktes
- Abkühlzeit
- maximaler Aufheizgradient
- minimaler Abkühlgradient

Das von uns empfohlene Lötprofil beschreibt den typischen Verlauf sowie die Prozessgrenzen. In der Vorheizphase werden Platine und Bauelemente schonend vorgeheizt. Der Aufheizgradient beträgt  $\leq +3$  K/s. Parallel dazu wird die Lotpaste „aktiviert“. In der Zeit oberhalb der Schmelztemperatur 217 °C wird das Lot flüssig, verbindet die Bauelemente mit den Anschlüssen auf der Platine. Dabei wird die maximale Temperatur von 245 °C bis 254 °C zwischen 10 und 40 Sekunden gehalten. In der Abkühlzeit bei  $\geq -6$  K/s härtet das Lot aus. Platine und Bauelemente werden nicht zu rasch abgekühlt, um Spannungsrisse zu vermeiden.